

## PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

Názov výdavku	Kategória výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
<b>a) Feasibility studies, costs of obtaining the permissions required</b>						
Feasibility study & chip tech selection (2024)	f) výdavky na štúdie uskutočniteľnosti vrátane prípravných technických štúdií a výdavky na získanie povolení potrebných na realizáciu projektu	kus	1	33 189,12	33 189,12	Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu Prípravná štúdia uskutočniteľnosti k výberu polovodičovej implementačnej technológií, cenové a technické porovnanie technológií. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B29 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation.
<b>b) Costs of instruments / equipment</b>						
Computation/Simulation Server incl. A/C (2024)	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada	6	4 968,60	29 811,60	Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu Nákup a inštalácia dátovej a CAD farmy severov s príslušenstvom (e.g. denná archivácia) a potrebným chladením. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B31 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Workstations/Laptops incl basic SW (2024)	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada	12	4 968,60	59 623,20	Technická výpočtová výbava pre personál v podobe hardwaru a softwaru e.g. laptop, monitor, tablet, MS Office balík, klávesnica, Wifi/5G stick etc. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B32 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<b>d) Costs of materials / supplies</b>						
MPW prototyping cost (10nm <sup>2</sup> ) in 28-22-20nm (2024)	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada	1	273 273,00	273 273,00	Výroba sady polovodičových čipových prototypov obsahujúca viaceré položky (výroba masiek, výroba waferov, skladovanie masiek & waferov, rôzne výrobné hold-on opcie, transport), vo vybranej polovodičovej technológii e.g. s minimálnou tranzistorovou veľkosťou 28-22-20 nanometrov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B40 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
MPW/MLM prototyping cost (10nm <sup>2</sup> ) in 130-180-350nm (2024)	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada	1	186 322,50	186 322,50	Výroba sady polovodičových čipových prototypov obsahujúca viaceré položky (výroba masiek, výroba waferov, skladovanie masiek & waferov, rozne výrobné hold-on opcie, transport), vo vybranej polovodičovej technológii napr. s minimálnou tranzistorovou veľkosťou 130-180-350 nanometrov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B44 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation.
Prototype Packaging (2024)	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada	1	93 161,25	93 161,25	Zákazkový vývoj puzdier, výroba sady čipových puzdier pre vyvinuté polovodičové prototypy ako i samotné zapuzdrenie (assembly, rezanie waferov) vyrobených čipových prototypov pomocou drátového bondingu alebo flip-chip kontaktných guľičiek. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B46 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Evaluation Board including FPGA (2024)	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada	1	149 058,00	149 058,00	Vývoj (HW & SW) a výroba na mieru vyhotovenej sady meracích alebo testovacích dosiek slúžiacich na evaluáciu a testovanie u zákazníka alebo v laboratóriu, vrátane nákupu elektronických a mechanických súčiastok a ich osadenie na doskách. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B47 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation.
Chip sockets (2024)	c) výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt	sada	1	62 107,50	62 107,50	Sada čipových soketov/pátíc alebo iného mechanického upevnenia pre testovanie a meranie polovodičových čipov na elektronickej doske. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B48 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation

<i>Matlab-Simulink/Python/National Instruments licences (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		1	52 170,30	52 170,30	Nákup sady programových licencií na tvorbu matematických programovacích modelov alebo ich simulácií e.g. Matlab, Python etc. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B49 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>CAD Licence Tanner (Purchase) (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		2	37 264,50	74 529,00	Nákup alebo leasing sady licencií CAD programov na návrh a simuláciu elektronických obvodov, v ktorej sa vyvíjajú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B50 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>CAD Maintenance Tanner (Annually) (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		2	8 695,05	17 390,10	Ročná aktualizácia a správčovský poplatok za CAD licenciu, v ktorej sa vyvíjajú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B51 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>CAD Simulator Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease) (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		3	136 636,50	409 909,50	Nákup alebo leasing sady licencií CAD programov na návrh a simuláciu elektronických obvodov, v ktorej sa vyvíjajú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B52 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>CAD Layout Editor Licence (Purchase) (Juspertor) (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		1	4 968,60	4 968,60	Nákup CAD programových licencií, v ktorých sa vyvíjajú a navrhujú polovodičové čipy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B53 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>CAD Layout Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease) (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		1	161 479,50	161 479,50	Nákup alebo leasing sady licencií CAD programov na návrh a verifikáciu fyzikálnych masiek polovodičových čipov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B54 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>CAD Cadence/Synopsys/Mentor other licences (Lease) (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		1	167 690,25	167 690,25	Nákup CAD programovej licencie, v ktorej sa vytvárajú návrhy čipov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B55 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>IT Infrastructure (network setup&amp;maintenance) (2023)</i>	c) výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt	sada		2	3 549,00	7 098,00	Nastavenie alebo leasing rozšírenej sady licencií programov na návrh, simuláciu alebo verifikáciu polovodičových čipov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B57 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>IT Infrastructure (network setup&amp;maintenance) (2024)</i>	c) výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt	sada		2	3 726,45	7 452,90	Nastavenie alebo leasing rozšírenej sady licencií programov na návrh, simuláciu alebo verifikáciu polovodičových čipov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B57 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Remote working cooperation platform (2024)</i>	a) výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu	sada		22	1 242,15	27 327,30	Nastavenie a údržba siete výpočtovej techniky prepojenej so serverom, údržba licencií alebo inštalácia nových programov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B58 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<b>e) Costs for patents / intangible assets / contractual research</b>						<b>0,00</b>	<b>Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu</b>
<i>Digital HDL Synthesis (2024)</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	sada		2	160 591,86	321 183,72	Dodávka sady digitálnej HDL syntézy od kontraktora, vývoj elektronickej schémy z abstrakného opisu hardwaru, mapping na správnu čipovú technológiu alebo jej simulácia. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B60 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Design Contract: Multipath broadband amplifier (2024)</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	sada		1	308 830,50	308 830,50	Dodávka sady na mieru vyvinutých širokopásmových zosilňovačov spĺňajúcej internú špecifikáciu v CTSD ADC. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B62 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Layout Contract (2024)</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	sada		2	123 532,20	247 064,40	Dodávka sady na mieru vyvinutého a nakresleného layoutu pre špecifické čipové bloky. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B63 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Digital HDL design&amp;FPGA implementation of postprocessing (2024)</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	sada		1	55 589,49	55 589,49	Dodávka digitálneho HDL dizajnu a jej následnej implementácie v FPGA podľa špecifikácie CTSD systému. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B64 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation

<i>Design of evaluation board (2024)</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	sada	1	123 532,20	123 532,20	Vývoj (HW & SW) a výroba na mieru vyhotovenej sady meracích alebo testovacích dosiek slúžiacich na evaluáciu a testovanie u zákazníka alebo v laboratóriu, vrátane nákupu elektronických a mechanických súčiastok a ich osadenie na doskách. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B65 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Contractual research with ind. partners (2024)</i>	d) výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív, výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt	sada	1	185 298,30	185 298,30	Dodávka podporných vedeckých služieb. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B67 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<b>f) Personnel / administrative costs including overheads</b>					0,00	Nákladová skupina podľa štruktúry Funding gapu
<b>f1) Employees</b>						Personál, ktorý sa plánuje zamestnať na trvalý pracovný pomer
<i>Technical Lead - Design Engineer (2023)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	4	11 968,00	47 872,00	Navrhuje elektronické obvody a schémy na úrovni celého systému podľa špecifikácie zákazníka/projektu, simuluje elektronické obvody a schémy na úrovni blokov ale i celého systému (napr A/D prevodníka), špecifikuje jednotlivé bloky s ich parametrami ako zosilnenie, sirka pasma, maximálny prípustný sum a nelinearne zkeslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronických obvodov zadanych svojim podriadeným "Design Engineer" (senior & junior) a tiež dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za spravnosť a funkcnosť celeho systému pred odovzdaním elektronického chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova výroba). Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B70 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Technical Lead - Design Engineer (2024)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	7 411,93	88 943,18	Navrhuje elektronické obvody a schémy na úrovni celého systému podľa špecifikácie zákazníka/projektu, simuluje elektronické obvody a schémy na úrovni blokov ale i celého systému (napr A/D prevodníka), špecifikuje jednotlivé bloky s ich parametrami ako zosilnenie, sirka pasma, maximálny prípustný sum a nelinearne zkeslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronických obvodov zadanych svojim podriadeným "Design Engineer" (senior & junior) a tiež dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za spravnosť a funkcnosť celeho systému pred odovzdaním elektronického chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova výroba). Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B70 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Technical Lead - Design Engineer (2025)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	8 474,31	101 691,71	Navrhuje elektronické obvody a schémy na úrovni celého systému podľa špecifikácie zákazníka/projektu, simuluje elektronické obvody a schémy na úrovni blokov ale i celého systému (napr A/D prevodníka), špecifikuje jednotlivé bloky s ich parametrami ako zosilnenie, sirka pasma, maximálny prípustný sum a nelinearne zkeslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronických obvodov zadanych svojim podriadeným "Design Engineer" (senior & junior) a tiež dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za spravnosť a funkcnosť celeho systému pred odovzdaním elektronického chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova výroba). Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B70 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation

Technical Lead - Design Engineer (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	10	6 588,38	65 883,84	Navrhuje elektronické obvody a schémy na úrovni celého systému podľa špecifikácie zakazníka/projektu, simuluje elektronické obvody a schémy na úrovni blokov ale i celého systému (napr A/D prevodníka), špecifikuje jednotlivé bloky s ich parametrami ako zosilnenie, sirka pasma, maximálny prípustný súm a nelinearne zkraslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronických obvodov zadanych svojim podriadeným "Design Engineer" (senior & junior) a tiež dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za spravnost a funkcnost celého systému pred odovzdaním elektronického chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova vyroba). Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B70 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Technical Lead - Design Engineer (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	6 779,45	81 353,37	Navrhuje elektronické obvody a schémy na úrovni celého systému podľa špecifikácie zakazníka/projektu, simuluje elektronické obvody a schémy na úrovni blokov ale i celého systému (napr A/D prevodníka), špecifikuje jednotlivé bloky s ich parametrami ako zosilnenie, sirka pasma, maximálny prípustný súm a nelinearne zkraslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronických obvodov zadanych svojim podriadeným "Design Engineer" (senior & junior) a tiež dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za spravnost a funkcnost celého systému pred odovzdaním elektronického chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova vyroba). Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B70 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	10	4 632,46	46 324,58	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtry, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napájania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, súm, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za spravnost a funkcnost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	4 766,80	57 201,59	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtry, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napájania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, súm, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za spravnost a funkcnost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation

Design Engineers (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	10	4 632,46	46 324,58	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtre, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napájania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, šum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za správnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	4 766,80	57 201,59	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtre, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napájania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, šum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za správnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	10	4 632,46	46 324,58	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtre, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napájania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, šum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za správnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	4 766,80	57 201,59	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtre, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napájania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, šum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za správnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Layout Engineer (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	10	3 474,34	34 743,43	Navrhuje fyzikálne masky pre elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovač, komparátor, RC-filter, zdroj referenčného napätia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj napájania prúdom: current biasing) a následne overuje ich správnú realizáciu pomocou testov: DRG a LVS. Generuje parazitné R,L,C elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje úzko na ich minimalizácii. Zodpovedá za správnosť fyzikálneho designu jednotlivých blokov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B73 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation

Layout Engineer (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	3 575,10	42 901,19	Navrhuje fyzikálne masky pre elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilňovač, komparátor, RC-filter, zdroj referenčného napätia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj napájania prúdom: current biasing) a následne overuje ich správnu realizáciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje úzko na ich minimalizácii. Zodpovedá za správnosť fyzikálneho designu jednotlivých blokov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B73 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation
Layout Engineer (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	10	3 474,34	34 743,43	Navrhuje fyzikálne masky pre elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilňovač, komparátor, RC-filter, zdroj referenčného napätia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj napájania prúdom: current biasing) a následne overuje ich správnu realizáciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje úzko na ich minimalizácii. Zodpovedá za správnosť fyzikálneho designu jednotlivých blokov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B73 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation
Layout Engineer (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	3 575,10	42 901,19	Navrhuje fyzikálne masky pre elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilňovač, komparátor, RC-filter, zdroj referenčného napätia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj napájania prúdom: current biasing) a následne overuje ich správnu realizáciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje úzko na ich minimalizácii. Zodpovedá za správnosť fyzikálneho designu jednotlivých blokov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B73 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation
Layout Engineer (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	9	3 474,34	31 269,09	Navrhuje fyzikálne masky pre elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilňovač, komparátor, RC-filter, zdroj referenčného napätia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj napájania prúdom: current biasing) a následne overuje ich správnu realizáciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje úzko na ich minimalizácii. Zodpovedá za správnosť fyzikálneho designu jednotlivých blokov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B73 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation
Layout Engineer (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	3 575,10	42 901,19	Navrhuje fyzikálne masky pre elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilňovač, komparátor, RC-filter, zdroj referenčného napätia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj napájania prúdom: current biasing) a následne overuje ich správnu realizáciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje úzko na ich minimalizácii. Zodpovedá za správnosť fyzikálneho designu jednotlivých blokov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B73 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation
f2) Freelancers						Personál, ktorý sa neplánuje zamestnať na trvalý pracovný pomer napríklad z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov alebo krátkeho projektového rozpočtu v počiatočnej fáze
IPCEI Coordinator (2023)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	2	5 142,50	10 285,00	Zodpovedá za koordináciu komunikácie, reportingu a výkazníctva medzi MH a firmou Continium a zabezpečenie všetkých náležitostí. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B76 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation
IPCEI Coordinator (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	5 661,89	67 942,71	Zodpovedá za koordináciu komunikácie, reportingu a výkazníctva medzi MH a firmou Continium a zabezpečenie všetkých náležitostí. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B76 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation

<i>IPCEI Coordinator (2025)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	5 826,09	69 913,05	Zodpovedá za koordináciu komunikácie, reportingu a výkazníctva medzi MH a firmou Continium a zabezpečenie všetkých náležitostí. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B76 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hároku Inflation
<i>Management Accountant (2024)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	10 294,35	123 532,20	Zodpovedný za interné účtovníctvo, reporting a manažment finančných ukazovateľov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B77 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hároku Inflation
<i>Management Accountant (2025)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	10 592,89	127 114,63	Zodpovedný za interné účtovníctvo, reporting a manažment finančných ukazovateľov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B77 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hároku Inflation
<i>Financial Accountant/Biz. Dev (2023)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	2	23 375,00	46 750,00	Zodpovedný za finančné plánovanie, tvorbu firemnej stratégie a tvorbu odberateľských kanálov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B78 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hároku Inflation
<i>Financial Accountant/Biz. Dev (2024)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	25 735,88	308 830,50	Zodpovedný za finančné plánovanie, tvorbu firemnej stratégie a tvorbu odberateľských kanálov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B78 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hároku Inflation
<i>Financial Accountant/Biz. Dev (2025)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	26 482,22	317 786,58	Zodpovedný za finančné plánovanie, tvorbu firemnej stratégie a tvorbu odberateľských kanálov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B78 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hároku Inflation
<i>Technical Project Manager (2023)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	1	14 025,00	14 025,00	Definuje parametre a architektúru navrhovaného čipu (napr. A/D prevodníka), robí návrh architektúry systému v matematických programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre (koeficienty spätnej väzby, šírka pásma, sum), definuje pod-bloky a definuje ich parametre (napr. zesílenie, šírka pásma, maximálny sum a nelineárnosť, maximálna spotreba prúdu) a overuje funkčnosť celého systému na abstraktnej úrovni pomocou behavioural simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivým návrhom elektronických schém daných podblokov. Zodpovedá za návrh elektronických obvodov, schémy a ich layout (fyzikálny návrh masiek), zodpovedá za správnosť a funkčnosť celého systému/čipu z hľadiska simulácie fyzikálnych parametrov (napr. v CAD software pomocou SPICE simulátora) a tiež za správnosť v návrhu layoutu (napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funkčnosť celého systému aj s ich reálne generovanými parazitnými R,L,C elementami, pred odovzdaním čipu do produkcie (MPW prototyping alebo sériová výroba). Diskutuje návrh systému so zákazníkmi alebo partnermi v EU projekte, zodpovedá za reporting voči EU/Ministerstvu a píše vedecké publikácie pre konferencie a odborné časopisy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B69 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hároku Inflation

<p>Technical Project Manager (2024)</p>	<p>e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie</p>	<p>person-month</p>	<p>12</p>	<p>15 441,53</p>	<p>185 298,30</p>	<p>Definuje parametre a architektúru navrhovaného čipu (napr. A/D prevodníka), robí návrh architektúry systému v matematických programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre (koeficienty spätnej väzby, šírka pásma, sum), definuje pod-bloky a definuje ich parametre (napr. zosilnenie, šírka pásma, maximálny sum a nelineárnosť, maximálna spotreba prúdu) a overuje funkčnosť celého systému na abstraktnej úrovni pomocou behavioural simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivým návrhom elektronických schém daných podblokov. Zodpovedá za návrh elektronických obvodov, schémy a ich layout (fyzikálny návrh masiek), zodpovedá za správnosť a funkčnosť celého systému/čipu z hľadiska simulácie fyzikálnych parametrov (napr. v CAD software pomocou SPICE simulátora) a tiež za správnosť v návrhu layoutu (napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funkčnosť celého systému aj s ich reálne generovanými parazitnými R,L,C elementami, pred odovzdaním čipu do produkcie (MPW prototyping alebo sériová výroba). Diskutuje návrh systému so zákazníkmi alebo partnermi v EU projekte, zodpovedá za reporting voči EU/Ministerstvu a píše vedecké publikácie pre konferencie a odborné časopisy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B69 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation</p>
<p>Technical Project Manager (2025)</p>	<p>e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie</p>	<p>person-month</p>	<p>12</p>	<p>15 889,33</p>	<p>190 671,95</p>	<p>Definuje parametre a architektúru navrhovaného čipu (napr. A/D prevodníka), robí návrh architektúry systému v matematických programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre (koeficienty spätnej väzby, šírka pásma, sum), definuje pod-bloky a definuje ich parametre (napr. zosilnenie, šírka pásma, maximálny sum a nelineárnosť, maximálna spotreba prúdu) a overuje funkčnosť celého systému na abstraktnej úrovni pomocou behavioural simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivým návrhom elektronických schém daných podblokov. Zodpovedá za návrh elektronických obvodov, schémy a ich layout (fyzikálny návrh masiek), zodpovedá za správnosť a funkčnosť celého systému/čipu z hľadiska simulácie fyzikálnych parametrov (napr. v CAD software pomocou SPICE simulátora) a tiež za správnosť v návrhu layoutu (napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funkčnosť celého systému aj s ich reálne generovanými parazitnými R,L,C elementami, pred odovzdaním čipu do produkcie (MPW prototyping alebo sériová výroba). Diskutuje návrh systému so zákazníkmi alebo partnermi v EU projekte, zodpovedá za reporting voči EU/Ministerstvu a píše vedecké publikácie pre konferencie a odborné časopisy. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B69 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation</p>
<p>Design Engineers (2023)</p>	<p>e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie</p>	<p>person-month</p>	<p>2</p>	<p>9 350,00</p>	<p>18 700,00</p>	<p>Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referencneho napätia, zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a iteratívne zlepšuje tieto elektronicke obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikalnych masiek pre nim navrhnuté obvody/bloky a tiež overuje zhoršenie vlastnosti obvodov po generovaní R,L,C parazitnych elementov a tým zodpoveda za spravnosť a funkcnosť svojho elektronickeho obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v hárkú Inflation</p>



Design Engineers (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	4	10 294,35	41 177,40	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referencného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prúdom: current biasing) a nasledne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulator) a iteratívne zlepšuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre ním navrhnuté obvody/bloky a tiež overuje zhoršenie vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a tým zodpoveda za spravnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	3	10 592,89	31 778,66	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referencného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prúdom: current biasing) a nasledne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulator) a iteratívne zlepšuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre ním navrhnuté obvody/bloky a tiež overuje zhoršenie vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a tým zodpoveda za spravnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	10 294,35	123 532,20	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referencného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prúdom: current biasing) a nasledne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulator) a iteratívne zlepšuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre ním navrhnuté obvody/bloky a tiež overuje zhoršenie vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a tým zodpoveda za spravnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2025)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	10 592,89	127 114,63	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referencného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prúdom: current biasing) a nasledne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulator) a iteratívne zlepšuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre ním navrhnuté obvody/bloky a tiež overuje zhoršenie vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a tým zodpoveda za spravnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
Design Engineers (2024)	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	10	10 294,35	102 943,50	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtre, zdroje referencného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulator) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za spravnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation

<i>Design Engineers (2025)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	10 592,89	127 114,63	Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivých blokov (zosilnovače, komparátori, RC-filtry, zdroje referenčného napätia, zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napájania prúdom: current biasing) a následne simuluje ich fyzikálne vlastnosti (zosilnenie, linearita, šum, spotreba prúdu) pomocou CAD software (SPICE simulátor) a interaktívne zlepšuje tieto elektronické obvody. Spolupracuje s Layout Engineer pri realizácii fyzikálnych masiek pre navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastností obvodov po generovaní R,L,C parazitných elementov a zodpovedá za správnosť a funkčnosť svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B71 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Technical Lead - Layout Engineer (2024)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	11 323,79	135 885,42	Navrhuje fyzikálne masky (physical layout design) pre elektronické obvody a schémy dodane navrharmi (Design engineers) na úrovni jednotlivých blokov (operacne zosilnovače, komparatori, filtre) ale i celého chipového systému v spolupráci s Technical Lead - Design Engineer. Zodpoveda za design checks: DRC (design rule check) a LVS, a za generovanie parazitných R,L,C elementov pomocou CAD software. Zodpoveda za definovanie požiadaviek na instaláciu CAD software a PDK (process development kits) pre navrh layoutu, ako i správne planovanie personálnych zdrojov a tiež dozera spolupracu vyvoja návrhom elektronických obvodov so svojim protejskom "Technical Lead -Design Engineer". Zodpoveda za správnosť a funkčnosť celého systému pred odovzdaním elektronického chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova výroba) zo strany fyzikalnych masiek a ich generovania parazitných R,L,C elementov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B72 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Technical Lead - Layout Engineer (2025)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	11 652,17	139 826,10	Navrhuje fyzikálne masky (physical layout design) pre elektronické obvody a schémy dodane navrharmi (Design engineers) na úrovni jednotlivých blokov (operacne zosilnovače, komparatori, filtre) ale i celého chipového systému v spolupráci s Technical Lead - Design Engineer. Zodpoveda za design checks: DRC (design rule check) a LVS, a za generovanie parazitných R,L,C elementov pomocou CAD software. Zodpoveda za definovanie požiadaviek na instaláciu CAD software a PDK (process development kits) pre navrh layoutu, ako i správne planovanie personálnych zdrojov a tiež dozera spolupracu vyvoja návrhom elektronických obvodov so svojim protejskom "Technical Lead -Design Engineer". Zodpoveda za správnosť a funkčnosť celého systému pred odovzdaním elektronického chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova výroba) zo strany fyzikalnych masiek a ich generovania parazitných R,L,C elementov. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B72 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Public Procurement Specialist (2023)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	2	5 610,00	11 220,00	Zodpovedný za vykonávanie procesov spojených s verejným obstarávaním. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B75 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Public Procurement Specialist (2024)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	6 176,61	74 119,32	Zodpovedný za vykonávanie procesov spojených s verejným obstarávaním. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B75 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<i>Public Procurement Specialist (2025)</i>	e) personálne a administratívne výdavky (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumno – vývojovo – inovačných činností, vrátane tých výskumno – vývojovo – inovačných činností, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie	person-month	12	6 355,73	76 268,78	Zodpovedný za vykonávanie procesov spojených s verejným obstarávaním. Porovnaj so schváleným Funding gapom bunka B75 navýšené o príslušnú inflačnú doložku v háрку Inflation
<b>Spolu oprávnené výdavky projektu</b>					<b>6 455 672,90</b>	